

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成25年8月22日(2013.8.22)

【公開番号】特開2012-96527(P2012-96527A)

【公開日】平成24年5月24日(2012.5.24)

【年通号数】公開・登録公報2012-020

【出願番号】特願2011-152207(P2011-152207)

【国際特許分類】

B 3 2 B 15/01 (2006.01)

B 3 2 B 15/04 (2006.01)

C 2 3 C 28/02 (2006.01)

H 0 5 K 3/00 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 15/01 K

B 3 2 B 15/04 A

C 2 3 C 28/02

H 0 5 K 3/00 R

【手続補正書】

【提出日】平成25年7月8日(2013.7.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

想定するプロセス温度内の耐熱性を有し、かつ、その上層に形成する積層膜の支持体となる部材からなるキャリアと、

前記キャリア上に形成された拡散防止層と、

前記拡散防止層上に、物理的成膜法により形成された金属層からなる剥離層と、

前記剥離層上に直接接して、酸性めっき浴を用いるめっき法により形成された金属層からなる転写層とを有し、

前記拡散防止層は、モリブデンもしくはリン又はその両者、及び、ニッケルもしくはコバルト又はその両者を含むめっき液から共析出した合金膜からなり、

前記剥離層と前記転写層は、同一の金属からなる

ことを特徴とする複合金属箔。

【請求項2】

前記剥離層と前記転写層が銅からなる

ことを特徴とする請求項1記載の複合金属箔。

【請求項3】

前記キャリアが銅箔である

ことを特徴とする請求項1記載の複合金属箔。

【請求項4】

前記拡散防止層の厚さが $0.05\text{mg}/\text{m}^2 \sim 1000\text{mg}/\text{m}^2$ であり、

前記剥離層と前記転写層の厚さの合計が $0.1\mu\text{m}$ 以上、 $12\mu\text{m}$ 以下である

ことを特徴とする請求項1～3のいずれか一項に記載の複合金属箔。

【請求項5】

前記キャリアの片側に形成された前記拡散層、前記剥離層及び前記転写層を含む積層膜

と同じ構成の積層膜が前記キャリアの反対側にも形成されていることを特徴とする請求項 1 ~ 4 のいずれか一項に記載の複合金属箔。

【請求項 6】

想定するプロセス温度内の耐熱性を有し、かつ、その上層に形成する積層膜の支持体となる部材からなるキャリアを準備する工程 (S 1) と、

前記キャリアの少なくとも一方の表面に拡散防止層を形成してなる拡散防止層形成工程 (S 2) と、

前記拡散防止層の表面に物理的成膜法により金属層からなる剥離層を形成してなる剥離層形成工程 (S 3) と、

前記剥離層の表面に酸性めっき浴を用いるめっき法により前記剥離層と同一の金属から構成される転写層を形成してなる転写層形成工程 (S 4) と、

を有することを特徴とする複合金属箔の製造方法。

【請求項 7】

前記拡散防止層形成工程 (S 2) と前記剥離層形成工程 (S 3) とを有することにより

250 温度領域まで加熱されても剥離可能である

ことを特徴とする請求項 6 記載の複合金属箔の製造方法。

【請求項 8】

プリント配線板を形成するための基材上に、

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項に記載の複合金属箔を転写し、

前記剥離層で前記剥離層と前記転写層とを剥離して

得られたプリント配線板。